

歡迎學期實習生與暑期實習生投遞履歷

職務名稱	徵求 人數	廠區	工作內容	條件
光學量測實習生	2-3	力行廠	A. 光學數據量測 B. 顯示模式顏色調校 C. 關鍵元件實驗驗證 D. 元件供應商品質確認 E. 光學料件關鍵規格數位化建檔 F. 光學軟體ASAP code的整理與彙整 G. 光學實驗室管理	1. 科系：光電/理工相關 2. 門檻 (1) 大學二年級以上 (2) 具備Excel, PPT資料彙整 簡報製作基礎能力
軟體測試實習生	1-2	力行廠	A. 使用UiPath or Katalon，撰寫軟體自動化測試 B. 協助RD自我測試 C. 協助多國語言字串表維護	1. 科系：資工/電機/電子/資管 2. 門檻： (1) 具備基礎撰寫程式能力 (2) 具備簡報和文件製作基礎能力

歡迎學期實習生與暑期實習生投遞履歷

職務名稱	徵求人數	廠區	工作內容	條件
電子電機實習生	1-2	竹南廠	A. 電路焊接 B. 車載產品文件彙整 C. 實驗樣品除錯&組裝 D. 實驗數據整理	1.科系：理科 2.門檻： (1)大學、碩士 (2)具備基本電子電路基礎知識，有光學知識更佳
光學材料驗證實習生	1-2	竹南廠	A. 新材料驗證 B. 光學量測 C. 數據整理	1.科系：電機電子工程相關,材料工程相關,光電工程相關 2.門檻： (1)大學、碩士 (2)具備基本光學知識

正職缺額

職務名稱 (附104超連結)	徵求 人數	廠區	工作內容	條件
研發類-資深光學工程師 	2	力行廠	A.光機實驗除錯 B.光機設計模擬(熟ASAP and Zemax) C.色彩調教 D.協助計劃量產 E.創新產品開發 and 應用	碩士以上，無經驗可 學習速度快、具執行能力、具危機處理能力 熟悉操作ASAP, ZEMAX, Code V, Light Tool佳 英文程度中等(約TOEIC 500分以上)
研發類-熱傳工程師 	2	力行廠	影像產品開發之熱傳驗證對策 影像產品開發之噪音對策解決 新技術開發評估	碩士以上，一年以上工作經驗 科系：機械、航太科系尤佳 熟悉icepak、flotherm、solidworks者佳
研發類-韌硬體系統整合工程師 	1	力行廠	A.韌體及軟體開發 B.設備系統整合開發 C.協同驗證與除錯硬體 D.排除工廠生產技術性問題 E.硬體電路設計	大學以上，無經驗可 科系：電子系尤佳 熟悉電子電路、C、C#、C++者佳

正職缺額

職務名稱 (附104超連結)	徵求 人數	廠區	工作內容	條件
研發類-電子工程師 	1-2	力行廠	A. 投影機線路及新技術應用設計 B. 投影機功能開發驗證及除錯 C. 跨團隊溝通及整合專案進度 D. 指導產線及生產技轉 E. 創新應用/技術研發及專利撰寫	學歷要求：專科、大學以上 科系要求：電機電子工程相關 擅長工具：Cadence, Allegro, and OrCAD 工作技能：PCB電路板設計、電子電路設計 其他條件 1. 瞭解投影機系統架構 2. 具備硬體電路設計基礎 3. 具備整合分析、團隊合作、跨部門溝通能力
研發類-韌體工程師 	1-2	力行廠	主要職責： 負責投影機韌體系統開發 主要任務： A.新專案技術開發 B.專案問題處理 C.Linux相關開發 D.處理客戶及工廠反應之事項 E.DC/EC文件處理	學歷要求：大學以上 科系要求：資訊工程相關,資訊管理相關,電機電子工程相關 擅長工具：Linux, MCU, C, C++, Firmware
研發類-FPGA設計工程師 	1-2	力行廠	A. 負責高階投影機FPGA開發 B. 承接 FPGA (XILINX/ALTERA) 設計 C. 數位電路設計、驗證與模擬 D. 影像系統或數位影像處理演算法設計與實現	學歷要求：大學以上 科系要求：資訊工程相關、電機電子工程相關 其他條件 1. 熟悉RTL Coding 2. 熟悉數位電路設計
研發類-軟體工程師 	1-2	力行廠	1. Windows AP開發 (Qt)。 2. 影像演算法資料庫整合與維護。 3. 軟體架構規劃與實作。 4. 協助像測產品開發、試產驗證問題排除與量產導入。 5. 需跨單位合作進行開發。	學歷要求：大學以上 @ 必要條件： 1. 熟悉C/C++程式語言開發 2. 熟悉Windows App開發 3. 熟悉OpenCV函式庫 @ 加分條件： 1. 具備影像處理與色彩學背景 2. 熟悉Linux，並有相關開發經驗